

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中金基金、方正证券、人保资产、中信证券、长江养老、申万菱信基金、平安基金、信达澳银基金、深圳正圆、上银基金、海富通基金、摩根士丹利华鑫基金、前海人寿、广银理财、西部证券、进门财经、天弘基金、建信基金、汐泰投资、德邦基金、凯石基金、华宝基金、红土创新、金信基金、交银施罗德基金、中银基金、国泰基金、长城基金、西部利得基金、万家基金、南华基金、国泰君安、竣弘投资、上海锐至、星石投资、广银理财、广东银石、利位投资、汇添富基金、前海恒汇丰、中信保诚基金、财通基金、太平资产、天治基金、东方证券自营、易方达、永赢基金、于翼资产、朱雀基金、民生证券
时间	2023年2月
地点	公司会议室和电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监金良凯先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本经营情况介绍 甬矽电子成立于2017年11月，主要聚焦集成电路封测中的先进封装领域，主要终端包括消费类电子、汽车电子、工规产品等。公司已入选国家第四批“集成电路重大项目企业名单”和“集成电路重大生产力布局十四五计划”。公司位于浙江省宁波市余姚市，于2022年11月在上交所科创板上市。公司的产

品主要包括 FC 类产品、SiP、QFN/DFN、MEMS 等产品。公司的使命是致力于成为中国集成电路封测领域的世界级企业，愿景是成为行业内最具竞争力的高端 IC 封测企业。公司客户基本涵盖了国内各个细分领域的客户，具体可以参考招股书披露的客户情况。随着客户这几年的高速发展，公司也取得了相对快速的发展。公司微电子高端集成 IC 封装测试二期项目的投资建设正在积极开展中，同时布局了全套晶圆“凸点工艺(Bumping)”产品线等，公司正在努力跟上客户快速发展的步伐。

二、交流的主要问题及回复

1、后续研发投入以及研发人员方面的规划？

2019 年-2022 年 6 月，公司研发投入金额分别为 2,826.50 万元、4,916.63 万元、9,703.86 万元和 6,021.12 万元，呈稳定上升趋势。未来，公司将根据自身发展战略和市场需求情况，继续加大研发投入力度，持续完善研发人员储备战略，提高研发人员的专业能力。从公司产品结构布局看，晶圆级封装业务是公司的重点发展方向之一，在一些与高算力芯片等先进领域密切相关的业务中，公司也做了一些前瞻性研究以及相对应的专利等方面的布局，这也是公司后期研发布局的一个重点，技术人员及其他技术相关投入也会持续的增加。

2、23 年来看，公司的增长驱动力主要会是在哪些领域或者是哪些客户上？

公司将以市场为导向、以技术为支持、以诚实守信为根本原则，不断提高技术实力，为客户提供最优的半导体封装测试技术解决方案。一方面，公司将在保证封装和测试服务质量的前提下，进一步扩大先进封装产能，提高公司服务客户的能力；另一方面，随着先进制程的不断向前演进，芯片制造工艺正变得复杂而且成本高昂。在应用多元化的今天，要求公司具备更加灵活和多样的集成方式，这需要从以前的二维平面向三维立体进行拓展，将不同功能的芯片和元器件整合封装，实现异构

集成。公司现有的 SiP 等先进封装技术是 Chiplet 模式的重要实现基础，Chiplet 模式的兴起有望驱动先进封装市场快速发展。公司在 SiP 领域具备丰富的技术积累，同时通过实施晶圆凸点产业化项目布局“扇入型封装”（Fan-in）、“扇外型封装”（Fan-out）、2.5D、3D 等晶圆级和系统级封装应用领域，为进一步拓展异构封装领域打下基础。公司将继续丰富封装产品类型，推动公司主营业务收入稳步提升，增强公司的技术竞争优势和持续盈利能力。具体而言，公司在 2023 年发展的重点在于，一方面要继续发力于公司既有的市场，并重点发展车规、工规产品线，同时因为车规工规的品质要求相对严格，整体的认证周期也较长，这就需要公司持续地进行精耕细作。另一方面，包括 Bumping 产线以及晶圆级封装的这部分也是公司的布局重点。

3、22 年 FC 类产品的单价增长较多的原因？

主要是由于产品及客户结构的差异、产品更新换代、工艺调整、具体应用领域等因素造成的。

4、今年四大类产品的价格趋势？

价格趋势需要根据具体的产品和客户的产品结构决定。从整个市场的反馈来看，2022 年整体来说相比 2021 年存在一定程度的下降，系对 2021 年市场过热的情况的修正，可能目前下游确实存在一些竞争的压力，但是价格方面整体呈现一个相对稳定的状态。产品的价格变动需要根据客户的产品需求进行具体分析。

5、公司先进封装有制程的概念吗，比如随着制程提升，毛利率或单价会有所提升？

封装与制程之间不完全是线性关系。一方面，越先进的制程涉及越复杂的工序和更高的要求，从而单价方面通常更高。但毛利率是根据产品、工序复杂性及原材料的占比而决定，所以无法得出最先进的工艺产品的利润率一定最高的结论。因此还需要根据产品的结构或者工艺的需求来决定。

6、后续随着募投项目达产，消费类下来，会不会出现产能过剩？

产能情况一方面取决于市场需求的变化，同时也跟产品结构和应用领域存在一定关系。因此公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。

7、高制程受限对公司有什么影响？

根据目前了解的信息，高制程受限主要系针对先进制程的晶圆代工存在一些限制，对公司目前而言没有直接的影响。此外，高制程受限推动了行业对于先进封装的积极探索，包括 Chiplet 在内的多芯片集成方案，公司在相关领域也进行了相应的布局 and 研发。

8、像 AP 类 SoC 芯片用哪种具体的封装形式是主流趋势？ AP 类 SoC 芯片用什么封装形式是否就是按照客户需求来？

AP 类 SoC 芯片主要封装形式较为多样，主要可以采用 WB-BGA、hybrid 封装、FC 类封装等多种封装形式。公司根据客户的需求以及封装的可实现度、可加工性以及成本各方面因素跟客户去进行探讨，从而选择最适合的封装形式。

9、公司现在基本都还是用的是进口的一些设备吗，还是向国内的厂家也有采购？

公司根据自身的工艺需求和客户的产品需求审慎进行设备选型，综合考虑量产的稳定性以及客户的接受度等因素，目前核心站别以进口设备为主。同时公司高度重视国产替代，主要站别均有相对应的国产设备的备选方案，并且有相对应的配置跟 demo，配套于公司在国产设备上的工艺开发。

10、公司现在的市占率？和长电、通富、华天相比，公司的优势在哪里？未来公司的市占率规划？

整体而言，在市占率方面，公司与全球头部 OSAT 企业可能还存在一定差距。公司自成立以来专注于先进封装领域的技术创新和工艺改进，在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品

(QFN/DFN) 等先进封装领域具有较为突出的技术先进性和工艺优势。在不断巩固系统级封装技术优势的同时，公司还积极进行先进晶圆级封装技术储备和产业布局。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了下游客户的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司缔结良好的合作关系，未来将持续提升公司的核心竞争力。

11、因为先进封装分别是在向上游晶圆级封装和下游模组的系统级封装发展，公司这两块也都有布局，公司会和晶圆厂和模组厂他们自己做晶圆级封装和系统级封装有竞争吗？

侧重不一样。晶圆厂如台积电等，其晶圆级封装可以做到超高密度的集成，可以用晶圆级技术以及晶圆制造设备来实现。但其客户更多的是在一些超高算力的产品方面的需求，或者会追逐具备最先进技术的产品，而产品的性能、各方面的集成度与价格和成本成正比，公司的客户需求不一定都是最先进的晶圆级集成技术服务，所以相对先进的技术服务的市场需求还非常大，为封测厂从事晶圆级封装留下了巨大的发展空间。

模组厂从传统的 SMT 向上延伸，技术上的差异相对较大。关于 SiP 的集成，需要有超高密度的 SMT 表面贴装、有 wafer 和倒装芯片这样的加工处理能力以及塑封的工艺整合能力。这方面恰好是公司封装的技术优势，而模组厂相对缺乏倒装芯片以及晶圆级的加工处理能力。

12、晶圆级封装现在的进度？

公司晶圆级封装尚未实现量产，正在进行部分晶圆级封装技术的基础研发和工艺论证工作，并布局了多项相关专利。公司目前正在实施的 Bumping 相关项目系晶圆级封装的重要实现基础，相关项目正在积极推进中。

13、为什么客户会和我们建立长期合作的关系？

客户与公司建立长期合作关系通常出于多方面的考虑。一

方面，受中美贸易关系影响，部分客户出于供应链安全考虑，极需安全、可靠的供应链来源，国产替代需求显著；另一方面，公司自成立以来专注于先进封装领域的技术创新和工艺改进，在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(FC类产品)、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)等先进封装领域具有较为突出的技术先进性和工艺优势。在不断巩固系统级封装技术优势的同时，公司还积极进行先进晶圆级封装技术储备和产业布局。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了下游客户的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司建立了良好的合作关系，持续提升了公司的核心竞争力。

14、目前公司在 MEMS 上的进展？

目前公司产品结构中 MEMS 的营收占比很小，主要以硅麦克风相关的产品为主，同时公司也在积极布局光学传感器相关的透明封装等产品，力争进一步提升市场份额。

15、不同的 FC 适用场景是怎么样？

公司目前的 FC 类产品主要包括 FC-LGA、FC-CSP、FC-BGA、BTC-LGA 等产品，下游客户主要根据自身产品的需求选择适合的封装结构。一般而言，FC-LGA 主要应用于射频或物联网通讯领域；FC-CSP 通常采用高密度封装方式，主要应用于 AP 类 SoC 芯片等领域；FC-BGA 产品尺寸相对较大，一般采用 8 层以上的多层封装基板，通常应用于 CPU、GPU 等领域；BTC-LGA 也是 FC 类产品的一种，采用高密度方式，主要应用于数字货币的算力芯片领域。

16、2.5D/3D 封装这方面的进展是怎么样？2.5D 封装用到硅基板是不是需要买各种设备？

公司目前正在对相关方面的布局，已经进行了对应技术的分析和调研，目前正处于前期布局和研发阶段。从行业惯例来看，晶圆级封装环节可以选择和一些晶圆厂进行合作，由晶

圆厂提供相对应的硅基板；也可以由封装厂直接购买相关设备，两种模式都有，企业会根据实际需要进行一定的选择。

17、芯片方向的布局打算？

目前公司在多个方向布局，并行发展。一方面，根据现在的市场方向，公司会进一步深耕目前重点客户并根据对应的市场情况进行扩展；另一方面，公司在技术上的提升和布局也在持续进行，包括：进一步提升 SiP 类产品整体的集成密度；同时，晶圆级封装目前有 FC 类的产品等，公司将重点加大细间距高密度 FC 芯片的封装工艺的研发投入；Bumping 以及后续的晶圆级封装产品也正处于积极开发过程中。同时公司也在储备相应的人才以及布局对应的专利。

18、制程到什么程度会考虑到叠封或者 chiplet？

首先，随着先进制程的不断向前演进，特别是演进至 5nm、3nm 甚至更低制程，芯片制造工艺正变得复杂而且昂贵。传统的 SOC 的芯片设计周期随着制程从 7 纳米往 5 纳米、5 纳米往 3 纳米的推进而逐渐变长，且设计的难度、整体流片以及晶圆的成本都越来越高。基于成本和设计周期考量，将原本采用 SOC 方式的产品拆分为一颗一颗的“小芯片”，将不同功能的芯片和元器件整合封装，即基于 Chiplet（芯粒）的模块化设计方法将实现异构集成，被认为是增强功能及降低成本的可行方法，有望成为延续摩尔定律的新路径。Chiplet 模式能满足现今高效能运算处理器的需求，Chiplet 模式的兴起有望驱动先进封装市场快速发展。其次，受美国贸易制裁影响，在先进制程受限的情况下，用多颗低制程如 14 纳米制程去实现 7 纳米甚至 5 纳米的芯片性能可能会成为一个替代性的选项。所以整体而言，我们觉得先进封装未来存在比较大的发展空间。

19、封测行业景气度展望？

景气度取决于下游需求的恢复，目前还没看到特别明显的回暖迹象，但下游客户的库存较去年整体有一定程度的下降。

20、为什么公司的业绩下滑比行业更晚？

一方面，公司成立时间较晚，本身处于成长阶段，2021年公司大量产能释放，所以不完全跟随周期变化而变化。2022年Q3开始感受到市场需求走弱。此外，公司定位中高端产品，只有QFN及以上产品，低端产品压力会更大一些。

21、为什么能获得这么高增速和份额提升？

主要受几个方面的影响。一方面，虽然甬矽电子是一家年轻的公司，但公司创始团队与核心团队中的大部分人员具备丰富的行业经验、技能、资源，对封测行业有着深刻的理解。另一方面，受中美贸易关系影响，部分客户出于供应链安全考虑，极需安全、可靠的供应链来源，国产替代需求显著；从公司自身层面而言，公司自成立以来专注于先进封装领域的技术创新和工艺改进，在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）等先进封装领域具有较为突出的技术先进性和工艺优势。在不断巩固系统级封装技术优势的同时，公司还积极进行先进晶圆级封装技术储备和产业布局。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了下游客户的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司建立了良好的合作关系，公司的核心竞争力持续提升。

22、二期 111 亿的扩产规划？

公司二期布局主要包括 Bumping、晶圆级封装、倒装类产品以及部分车规、工规的产品线，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。

23、111 亿扩产项目资金怎么来？

甬矽电子二期项目建设资金来源可分为自有资金、产业基金出资及银行贷款等债权融资。

24、为什么二期做了这么大扩产规划？

公司坚持自身中高端先进封装的定位，希望能够成长为中

中国大陆地区最具竞争力的一站式封测服务供应商之一。同时公司也会结合客户的需求与市场情况，逐步开展二期的投资节奏。

25、CPU、GPU 类客户的扩展规划？

算力芯片是公司重点布局的方向之一。2022 年公司已经开始接触这些客户，主要以国内客户为主，也包括一些海外客户。该类客户主要使用 ABF 基板，但该类基板非常紧缺。2022 年以来，ABF 基板供给慢慢放松，国内一些龙头的基板厂商也开始进入这一领域。公司将持续推进相关领域的规划和布局。

26、bumping 的规划？

公司正在积极实施 Bumping 项目，后续晶圆级封装产品也正处于积极开发过程中，同时公司也在储备相应的人才及专利。

27、为什么毛利率高于业内大厂？

毛利率主要与产品结构、客户结构、工序复杂性及原材料的占比、自动化水平能力、管理能力等综合因素相关。

28、有没有拓展海外龙头设计公司客户？

公司已经在进行相关的储备。从过去的发展看，甬矽电子 2018-2021 年的客户结构变化很快，公司持续开拓新客户，目前基本形成了以各个细分领域的龙头设计企业为主的客户结构。公司坚持大客户战略，坚持与客户共同发展进步，目前海外客户有 MTK，其他知名的客户也都是我们的战略发展方向。

29、现在行业稼动率不高，业内大厂会加剧竞争挤兑吗？

下游需求萎缩的情况下确实会加剧竞争，通常而言，门槛越低的产品竞争压力越大。公司凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，同众多国内外知名设计公司缔结良好的合作关系，也成为了部分客户的核心或主要供应商，合作相对稳定，客户一般情况不轻易更换供应商。

30、为什么收入/固定资产比例较低？

一方面可能与产品结构有关；另一方面，可能您观察的行

	<p>业内收入/固定资产比例相对较高的情形与折旧政策也存在一定联系，业内规模更大的友商成立时间长，可能存在部分早期设备在财务上已经折旧完，但是设备实际可使用的年限较长的情况。甬矽电子成立时间相对较短，设备还在正常的折旧年限内。</p> <p>31、规模大了以后毛利率会下降吗？低端产品会增加吗？</p> <p>毛利率主要与产品的结构、工序复杂性及原材料的占比、自动化水平能力、管理能力等综合因素相关。甬矽电子将长期坚持中高端先进封装产品的定位。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 28 日